

2024年11月19日  
ビアメカニクス株式会社

## 日本電気硝子株式会社と共同開発契約締結

ビアメカニクス株式会社（以下「当社」）は、日本電気硝子株式会社との間で、ガラスおよびガラスセラミックス製半導体パッケージ用無機コア基板の開発に向けた共同開発契約を締結しました。

近年の生成 AI やデータセンターにおける情報処理量の増加に伴い、CPU/GPU、HBM などを同一パッケージに統合するパッケージング技術の高度化が求められております。

そうした中、基板材料には、増大する消費電力を抑え、かつ、強度的・熱的安定性が高く伝送損失の少ない材料への市場期待が高まっています。

当社は、ドリル穴明機およびレーザー加工機を製造販売する企業として、これまでも、基板材料メーカー様の材料開発にご協力させて頂いておりますが、今般、ガラスおよびガラスセラミックス材料による基板開発に関して、日本電気硝子株式会社と共同開発契約を締結しました。

当社は、上記共同開発において、以下の取組みを進めることにしております。

- ① レーザー加工機によるクラックレス・ビア形成技術
- ② 実用化に向けた評価方法の確立 等

当社は、高度化する市場ニーズに貢献するため、引き続き、各種基板材料の開発に、ご協力してまいります。

以 上